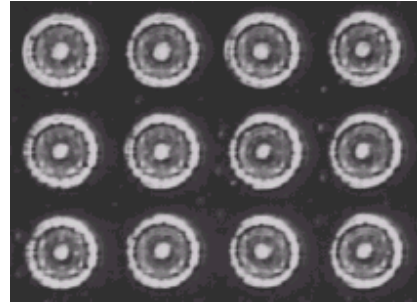


# ソルダバンピングペースト Solder Bumping Paste

## 特徴 Features

ソルダバンピングペーストは印刷,リフローによりソルダバンパを形成できます。  
CSP,BGA,フリップチップ用バンパ形成に適します。  
φ90 μmまでのバンパ形成が可能です。  
Auスタッドバンパ不要でバンパ形成できます。



ピッチ:0.25mm, バンパ径:0.18mm

## 仕様 Specification

品番	NL30G025RMA	K62G826RMA	備考
合金No.	SA3C5	62	
合金	Sn-3Ag-0.5Cu ※	Pb-62Sn-2Ag	
融点	217-220°C	179-190°C	
粉末粒径	10-25 μ	10-25 μ	
粉末形状	球形	球形	
フラックス含有量	10.6 %	9.5 %	JIS Z 3197
粘度	183 Pa·s	185 Pa·s	JIS Z 3284 スパイラル方式
チクソ指数	0.75	-	JIS Z 3284 スパイラル方式
塩素含有量	0.04%以下	0.035%以下	JIS Z 3197
水溶液抵抗	1000 Ωm以上	-	QQ-S-571E
絶縁抵抗	1×10 <sup>8</sup> Ω以上	1×10 <sup>8</sup> Ω以上	JIS Z 3284 条件B
銅板腐食試験	合格	合格	JIS Z 3197

※JP 3027441,USP 5527628

## 合金化学成分(%)

合金No.	Sn	Pb	Ag	Sb	Cu	Bi	Zn	Fe	Al	As	Cd
SA3C5	残	≤0.1	2.8-3.2	≤0.12	0.4-0.6	≤0.1	≤0.002	≤0.02	≤0.002	≤0.03	≤0.002
62	61-63	残	1.7-2.3	≤0.12	≤0.05	≤0.1	≤0.002	≤0.02	≤0.002	≤0.03	≤0.002

Sb,Cu,Biを除いた不純物元素合計0.08%以下

 内橋エステック株式会社

Uchihashi

〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 2-9-14

URL <http://www.uchihashi.co.jp/>

大阪営業 TEL 06-6962-6666 FAX 06-6962-6669

東京営業 TEL 03-3989-1481 FAX 03-3989-1487

[osk-sales@uchihashi.co.jp](mailto:osk-sales@uchihashi.co.jp)

[tky-sales@uchihashi.co.jp](mailto:tky-sales@uchihashi.co.jp)